

天通控股股份有限公司

关于购回天通银厦股权暨增资事项的完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、增资概况

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日召开的七届四次董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”或“标的公司”）增资扩股的议案》，同意银川经济技术开发区管理委员会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增资人民币 2 亿元，并授权公司管理层签署本次增资的相关合同。2017 年 10 月 26 日，天通银厦与银川育成投资有限公司（银川经济技术开发区管理委员会的下属全资子公司，简称“育成投资”）、银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）（育成投资为其有限合伙人，简称“育成产业基金”）签署了《增资协议》，其中育成投资增资 6,455 万元、育成产业基金增资 13,545 万元，合计持有天通银厦 20,000 万元的股权。《增资协议》约定，公司应于 2020 年 10 月 30 日前按合法有效的程序回购育成投资和育成产业基金因本次增资所获得的天通银厦股权，并于上述日期起 10 个工作日内将相关价款支付至其指定账户。详见公司 2017 年 9 月 28 日及 2017 年 10 月 27 日的公司公告。

二、进展情况

1、2020 年 11 月 6 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议》，育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由 2020 年 10 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。详见 2020 年 11 月 7 日的公司公告。

2、2021 年 1 月 8 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回

族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议二》，育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。详见 2021 年 1 月 9 日的公司公告。

3、2022 年 1 月 28 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议三》(以下简称“补充协议三”)，同意育成产业基金和育成投资按照补充协议三约定的条款和条件自 2022 年 1 月 1 日起继续持有标的公司合计 20,000 万元注册资本。详见 2022 年 1 月 29 日的公司公告。

4、2022 年 12 月 26 日，公司根据约定购回了育成产业基金因增资所获得的天通银厦 10,000 万元股权，回购金额合计 10,497.15 万元人民币。详见 2022 年 12 月 27 日的公司公告。

5、2023 年 3 月 1 日，公司根据约定购回了育成产业基金因增资所获得的天通银厦 3,545 万元股权，回购金额合计 3,747.97 万元人民币。详见 2023 年 3 月 2 日的公司公告。

三、本次回购情况

(一) 本次回购的基本情况

根据《增资协议》及补充协议三的相关条款约定，公司于 2023 年 9 月 12 日购回了育成投资因增资所获得的天通银厦全部股权，即 6,455 万元，回购金额为回购股权对应的投资本金+回购股权对应的投资本金×5 年期以上贷款市场报价利率(LPR)×实际持有该部分股权天数/365-已支付投资收益，即本次回购金额合计为 6,960.824411 万元人民币。

本次交易完成后，公司将直接持有天通银厦 100%的股权。

(二) 交易对方的基本情况

名称：银川育成投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 2 号楼 2 层

法定代表人：袁芳

注册资本：20000 万元

成立日期：2013年6月9日

经营范围：资产管理；创业投资；项目投资；股权投资；风险投资；资本运营；企业收购与重组；土地收购储备开发服务。

主要股东：银川经开发展集团有限责任公司

最近一年及一期的主要财务指标：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所审计，截至2022年12月31日，育成投资的资产总额为174,345.67万元，负债总额为43,550.39万元，资产净额为130,795.28万元；2022年度实现营业收入3,537.04万元，净利润357.52万元。

截至2023年6月30日，育成投资的资产总额为177,581.98万元，负债总额为46,795.23万元，资产净额为130,786.75万元；2023年1-6月实现营业收入70.2万元，净利润-14.19万元。（未经审计）

与本公司及下属子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）回购标的基本情况

天通银厦新材料有限公司

统一社会信用代码：916411003950521388

企业类型：其他有限责任公司

住所：银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人：滕斌

注册资本：88500万元

成立时间：2014年7月18日

经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次回购前后，天通银厦的股权结构如下：

股东名称	本次回购前		本次回购后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
天通控股股份有限公司	82,045	92.71	88,500	100.00

银川育成投资有限公司	6,455	7.29	0	0
合计	88,500	100.00	88,500	100.00

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标	2022年12月31日 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	2023年6月30日 未经审计
资产总额	179,112.41	184,352.76
负债总额	59,988.86	63,254.41
净资产	119,123.55	121,098.35
	2022年度	2023年1-6月
营业收入	54,708.63	25,939.94
净利润	9,836.09	1,973.21

四、对公司的影响

根据公司战略规划和经营需求，公司决定购回银川经济技术开发区管理委员会通过下属投资公司持有的剩余天通银厦股权，购回后，公司将直接持有天通银厦 100%的股权。本次交易不影响公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年9月14日